

The background of the entire image is a photograph of the Purdue University campus. At the top, a large metal archway spans the width of the frame, with the words "PURDUE UNIVERSITY" inscribed in its structure. Below the arch, a wide, light-colored paved walkway leads towards the center of the image. On either side of the path are green lawns and various shrubs, some with purple and yellow flowers. In the background, several large, multi-story brick university buildings are visible under a clear blue sky. The overall scene is bright and sunny.

PURDUE DSCIC INTERNSHIP 2023 II

PURDUE
UNIVERSITY

West Lafayette, Indiana

Vive la experiencia Purdue

Purdue University es una de las universidades más prestigiosas en el campo de las ciencias e ingeniería. Está ubicada en la zona de influencia de la ciudad de Indianápolis, considerada el Hub Industrial-Logístico de USA.

El programa "**Purdue DSCIC Internship**" consiste en ocho (8) semanas de pasantía en un proyecto de innovación y tecnología en empresas de manufactura y logística de USA.

Los pasantes serán asignados a un equipo de profesores y alumnos de Purdue University.

El formato del programa será híbrido: siete (7) semanas en modalidad remota y una (1) semana presencial en el campus de la universidad.



PURDUE
UNIVERSITY

Plana Expertos



Steve Dunlop

Managing Director
GSCMI Global Supply
Chain Management
Initiative
DCMME Dauch Center for
Management of
Manufacturing Enterprises
Daniels School of
Business



Gary Mercado

Senior Scientist
Krenicki Center Business
Analytics & Machine
Learning
Daniels School of
Business



Roy Vasher

Senior Advisor & Faculty
GSCMI & DCMME
Daniels School of
Business



Eduardo Huerta-Mercado

Research Scholar
Burton D. Morgan Center for
Entrepreneurship
Discovery Park

Senior Advisor
GSCMI & DCMME
Daniels School of Business

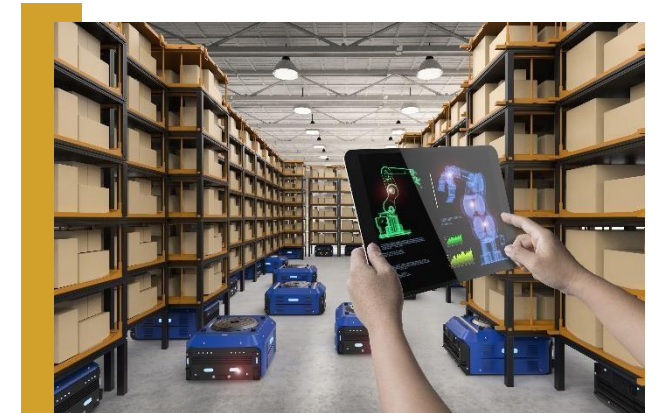
Alcance de los Proyectos

Los prototipos estarán basados en la aplicación de modelos de innovación y tecnología en la **Cadena de Suministro y Manufactura** para incrementar la productividad y reducción de costos.

Las tecnologías incluirán Data Analytics, Simulación, Internet de las Cosas, Inteligencia Artificial, Realidad Virtual y Aumentada (AR/VR), NoCode Apps, etc.

El alcance de los prototipos podrá considerar, por ejemplo:

- Desarrollo de NoCode Apps para gestión de proyectos
- Modelo de Data Analytics Electrical Vehicles
- Videoanalítica para gestión de almacenes.
- Modelo de optimización de Transporte.



Plan de Actividades

24 de abril al 31 de mayo.

- Convocatoria
- Inscripciones

22 de mayo al 9 de junio 2023

- Orientación de pasantes
- Asignación de proyectos – empresas USA
- Guía y autoestudio de herramientas y tecnologías

12 de junio al 4 de agosto 2023

- Entrenamiento en el trabajo
- Ejecución del proyecto (remoto)

7 al 11 de agosto (1 semana)

- Misión académica al campus Purdue
- Ejecución del proyecto (presencial)



PROGRAMA

Lunes 7 de agosto

Martes 8 de agosto

Miércoles 9 de agosto

**Bienvenida y Conferencia: TP3 –
Manufactura y Logística Inteligentes**
Steve Dunlop, GSCMI- DCMME
Daniels School of Business

Laboratorio de Logística Digital DSCIC:
Tecnologías Disruptivas

Almuerzo

Tour del Campus
Daniels School of Business
Purdue Memorial Union
Purdue Mall
Industrial Engineering “Gateway”
Neil Armstrong Hall

Laboratorio de Logística Digital DSCIC:
Equipo de proyecto
Desarrollo de pasantía

Almuerzo

SAI Subaru of Indiana Automotive
Visita guiada: JIT, 5S, Robotics
Automotriz – Planta de Ensamble



Taller: Tendencias en Supply Chain Digital
Eduardo Huerta-Mercado Herrera
Burton D. Morgan Center for
Entrepreneurship, Discovery Park

Bechtel Design Innovation Center
Fabricación Aditiva y Subtractiva
Proyectos Integrados de Tecnología

Almuerzo

Laboratorio de Logística Digital DSCIC:
Equipo de proyecto
Desarrollo de pasantía

PROGRAMA

Jueves 10 de agosto

Viernes 11 de agosto

Sábado 12 de agosto

Taller : Data Analytics aplicada

Dr. Gary Mercado, Krenicki Center for Data
Analytics & Machine Learning
Daniels School of Business

BIRCK Nanotechnology Center

Laboratorio de Nanotecnología

Almuerzo

Wabash National

Visita guiada: Lean Manufacturing
Fabricación y Ensamble Trailers



**Presentación de Proyectos Purdue DSCIC
Internship 2023 – II**

**Ceremonia de Clausura y Entrega de
Certificados**

Tarde Libre

Cena despedida



Costo del Programa

- El costo del programa asciende a:
 - 3,800.00 USD (habitación individual)
 - 3,400.00 USD (habitación doble compartida)

El pago se realiza mediante transferencia internacional a banco de USA
- El programa incluye:
 - Supervisión y monitoreo de la Pasantía (del 12 de junio al 11 de agosto 2023)
 - Misión académica Purdue University (del 7 al 11 de agosto 2023)
 - Alojamiento en Hotel: a 5 minutos del campus (6 noches)
 - Conferencias magistrales y talleres
 - Visitas guiadas a los Centros de Innovación de Purdue University
 - Visitas guiadas a empresas SIA y Wabash National
 - Transporte desde y hacia el aeropuerto Indianápolis (IND) o Chicago (ORD)
 - Transporte local a las actividades
 - ***Certificado de participación emitido por Purdue University***
- El participante deberá gestionar: (costos aproximados)
 - Pasaje aéreo = 700 USD
 - Seguro de viaje= 40 USD
 - Alimentación (6 días) = 300 USD

Beneficios para el participante



- Colaboración con una de las más prestigiosas universidades del mundo, líder en Ciencia y Tecnología.
- Transferencia de conocimiento de modelos de gestión y tecnologías de punta aplicados a las operaciones de manufactura y logística.
- Posicionamiento de liderazgo y referencia en Innovación y Tecnología a nivel local e internacional.
- Experiencia de ejecución de proyectos en empresas referentes de USA.
- Certificado de Participación emitido por GSCMI / DCMME – Daniels School of Business.

On Campus



PURDUE
UNIVERSITY

Eduardo Huerta-Mercado Herrera

ehuertamercado@bsdla.com

huertame@purdue.edu

M +51 936833074

M +1 (765) 775 6806

West Lafayette, Indiana